User's Guide

从 NXP 迁移到 MSPM0 的指南



摘要

本用户指南可协助您从 NXP 的 Arm® Cortex®-M0+ MCU 平台迁移到德州仪器 Arm Cortex-M0+ MSPM0 MCU 生态系统。本指南介绍了 MSPM0 开发和工具生态系统、内核架构、外设注意事项以及软件开发套件。目的是突出两个系列之间的差异,并利用现有的 NXP Arm Cortex 生态系统知识快速提升 MCU 中 MSPM0 系列的性能。

内容

1 MSPM0 产品系列概还	2
1.1 引言	
1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较	2
2 生态系统和迁移	3
2.1 软件生态系统比较	3
2.2 硬件生态系统	4
2.3 调试工具	5
2.4 迁移过程	6
2.5 迁移和移植示例	6
3 内核架构比较	13
3.1 CPU	
3.2 嵌入式存储器比较	13
3.3 上电和复位总结和比较	14
3.4 时钟总结和比较	
3.5 MSPM0 工作模式总结和比较	
3.6 中断和事件比较	20
3.7 调试和编程比较	<mark>23</mark>
4 数字外设比较	25
4.1 通用 I/O(GPIO、IOMUX)	25
4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)	25
4.3 串行外设接口 (SPI)	26
4.4 I2C	26
4.5 计时器(TIMGx、TIMAx)	<mark>27</mark>
4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)	28
4.7 实时时钟 (RTC)	<mark>28</mark>
5 模拟外设比较	28
5.1 模数转换器 (ADC)	28
5.2 比较器 (COMP)	30
5.3 数模转换器 (DAC)	31
5.4 运算放大器 (OPA)	32
5.5 电压基准 (VREF)	32
6 参考资料	33
N. P.	

商标

TI E2E[™], Code Composer Studio[™], LaunchPad[™], EnergyTrace[™], and BoosterPack[™] are trademarks of Texas Instruments.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere. 所有商标均为其各自所有者的财产。



1 MSPM0 产品系列概述

1.1 引言

MSP430™ MCU 是 TI 的经典微控制器,已有近 30 年的历史。最新一代推出了 MSPM0 系列。MSPM0 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成的超低功耗 32 位 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 32 位内核平台。这些成本优化型 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持扩展的工作温度范围并提供小尺寸封装。TI MSPM0 系列低功耗 MCU 包含具有不同模拟和数字集成度的器件,使工程师能够找到满足其工程需求的 MCU。MSPM0 MCU 系列将 Arm Cortex-M0+ 平台与超低功耗系统架构相结合,使系统设计人员能够在降低能耗的同时提高性能。

MSPM0 MCU 是 NXP 的 M0 MCU 的替代产品,具有很强的竞争力。本文档比较了器件功能和生态系统、以帮助从此类 NXP M0 MCU 迁移到 TI MSPM0 MCU 中。

1.2 NXP M0 MCU 与 MSPM0 的产品系列比较

表 1-1. MSPM0 和 NXP M0 MCU 的比较

	32K1xx 系列	KEA128x 系列	KM35x 系列	MSPM0Gx 系列	MSPM0Lx 系列	MSPM0Cx 系列
内核/频率	CM0+/48MHz	CM0+/48MHz	CM0+/75MHz	CM0+/ 32MHz-80MHz	CM0+/32MHz	CM0+/24MHz
电源电压	2.7V 至 5.5V	2.7V 至 5.5V	2.7V 至 3.6V	1.62V 至 3.6V	1.62V 至 3.6V	1.62V 至 3.6V
温度	-40°C 至 150°C	-40°C 至 125°C	-40°C 至 105°C	-40°C 至 125°C	-40°C 至 125°C	-40°C 至 125°C
存储器	256KB 至 128KB	128KB	512KB	128KB 至 32KB	64KB 至 8KB	16KB 至 8KB
RAM	高达 25 KB	高达 16 KB	高达 64 KB	高达 32 KB	高达 4 KB	1KB
EEPROM	高达 2 KB	高达 256B	不适用	如果器件小于 32KB 闪存,则仿 真容量高达 32KB 或整个闪存	如果器件小于 32KB 闪存,则仿 真容量高达 32KB 或整个闪存	如果器件小于 32KB 闪存,则仿 真容量高达 32KB 或整个闪存
GPIO (最大值)	28/43/58	58/71	72/99	高达 60	高达 28	高达 18
模拟	1 个 1Msps、12 位 ADC 、1 个比较器、 1 个 8 位 DAC	1 个 340Ksps、12 位 ADC 2 个比较器、 2 个 6 位 DAC	4 个 AFE 1 个 4.75Msps、 16 位 ADC 3 个比较器、 3 个 6 位 DAC	2 个 4Msps、12 位 ADC 3 个高速比较器 2 个运算放大器 1 个通用放大器 1 个 12 位 DAC	1 个 1.68Msps、 12 位 ADC 1 个高速比较器 1 个通用放大器 2 个 OPA	1 个 1.5Msps、12 位 ADC
通信(最大值)	1/2x SPI 1x I2C 2x UART 1x FlexCAN 1x FlexIO	2x SPI 2x I2C 3x UART 1x MSCAN	3x SPI 2x I2C 5x UART	2 个 SPI 2 个 I2C Fast+ 3 个 UART 1 个 UART -LIN 1 个 CAN-FD	1 个 SPI 2 个 I2C Fast+ 1 个 UART 1 个 UART (LIN)	1个 SPI 2个 I2C Fast+ 1个 UART (LIN)
计时器	2 个 16bit	3 个 16 位	6 个 16 位	6 个 16 位、 1 个 32 位	4 个 16 位	3 个 16 位
高级计时器	否	否	否	2 个 16 位高级	否	否
硬件加速器	不适用	不适用	RNGA	MATHACL	不适用	不适用
安全性	CSEc	唯一 ID、CRC	唯一 ID、 MMCAU、 RNGA、PRCR	CRC、TRNG、 AES256	CRC	CRC
低功耗	有效: 422.92/447.92μΑ/ MHz 待机 26/27μΑ	有效: 236.170μA/MHz 待机 2μA	有效: 165.07μA/MHz 待机 6.5μA	有效:96μA/MHz 待机:1.5μA	有效:71μA/MHz 待机:1μA	有效:71μA/MHz 待机:1μA

www.ti.com.cn 生态系统和迁移

2 生态系统和迁移

MSPM0 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。 MSPM0 MCU 还具有在线资源、MSP Academy 培训支持和 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持。

2.1 软件生态系统比较

表 2-1. 与 MSPM0 等效的 NXP 软件工具

** = ** * ***** *** *** *** *** *** ***						
	NXP	MSPM0				
IDE	MCUXpresso IDE	Code Composer Studio™ Theia				
软件配置	MCUXpresso 代码配置工具	SysConfig				
独立编程	不适用	UniFlash				
显示/演示 GUI 编辑器	GUI 指南	GuiComposer				

2.1.1 MSPM0 软件开发套件 (MSPM0 SDK)

MSPM0 SDK 提供软件 API、示例、文档和库,可帮助工程师在德州仪器 (TI) MSPM0+ 微控制器器件上快速开发应用程序。提供了各种示例来展示如何在每个受支持的器件上使用各功能区,这些示例可用作您开发自己的工程的起点。此外,MSPM0 SDK 中还包含交互式 MSP Academy 培训,以提供引导式学习路径。

示例文件夹分为 RTOS 和非 RTOS 子文件夹。这些文件夹包含每个 LaunchPad™ 开发套件的示例,并且按类别有序分类,例如较低级别的 DriverLib 示例、较高级别的 TI 驱动程序示例以及 GUI Composer、LIN、IQMath 等中间件示例等等。有关详细信息,请参阅 *MSPM0 SDK 用户指南*。

2.1.2 MCUXpresso IDE 与 Code Composer Studio IDE (CCS)

Code Composer Studio Theia IDE (CCS) 是与 NXP 的 MCUXpresso IDE 等效的 TI 产品。CCS 和 MCUXpresso 是基于 Eclipse 的免费 IDE,支持各自的 MCU 和嵌入式处理器产品系列。CCS 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用程序的工具,其中包含优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程构建环境、调试器、性能评测工具和许多其他功能。CCS 可作为桌面或基于云的 IDE 提供。

CCS 集成了 SysConfig 的 MSPM0 器件配置和自动代码生成功能,并在集成式 TI Resource explorer 中集成了 MSPM0 代码示例和 Academy 培训。CCS 提供一体式开发工具体验。

除 CCS 之外,表 2-2 中列出的业界通用 IDE 也支持 MSPM0 器件。

表 2-2. MSPM0 支持的 IDE

IDE	MSPM0
ccs	✓
IAR	✓
Keil	✓

2.1.3 MCUXpresso 代码配置工具与 SysConfig

SysConfig 是一个直观而全面的图形实用程序集合,用于配置引脚、外设、无线电、子系统和其他组件。它是与NXPs MCUXpresso 代码配置工具等效的 TI 产品。SysConfig 可帮助您直观地管理、发现和解决冲突,以便您有更多时间创建差异化应用程序。该工具的输出包括 C 头文件和代码文件,这些文件可与 MSPM0 SDK 示例配合使用,或用于配置定制软件。SysConfig 集成在 CCS 中,但也可以用作独立的程序。

有关详细信息,请参阅 MSPM0 SysConfig 指南。



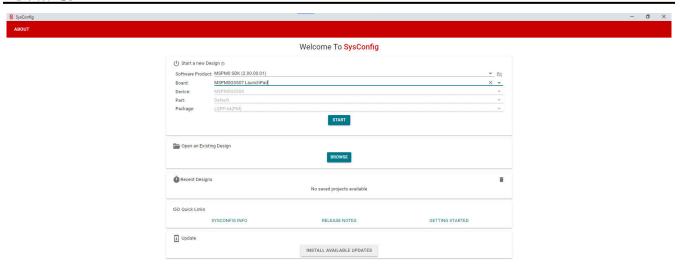


图 2-1. MSPM0 SysConfig

2.2 硬件生态系统

LaunchPad 开发套件是适用于 MSPM0 的唯一评估模块。LaunchPad 套件是易于使用的 EVM,其中包含在 MSPM0 上开始开发所需的一切内容。这包括一个板载调试探针,用于使用 EnergyTrace™ 技术进行编程、调试和测量功耗。MSPM0 LaunchPad 套件还具有板载按钮、LED 和温度传感器以及其他电路。40 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack 插件模块。您可快速添加无线连接、图形显示、环境检测等功能。

- LP-MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件
- LP-MSPM0L1306 LaunchPad 开发套件
- LP-MSPM0C1104 Launchpad 开发套件



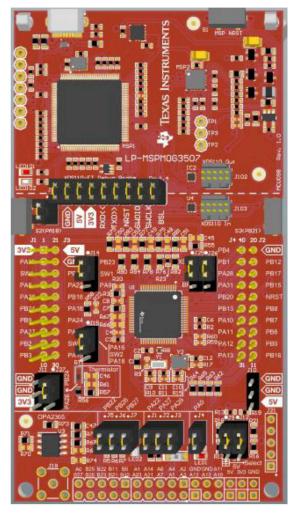


图 2-2. LP-MSPM0G3507 LaunchPad 开发套件

2.3 调试工具

调试子系统 (DEBUGSS) 将串行线调试 (SWD) 两线制物理接口连接到器件内的多个调试功能。MSPM0 器件支持调试处理器执行情况、器件状态和电源状态 (使用 EnergyTrace 技术)。图 2-3 显示了调试器的连接。

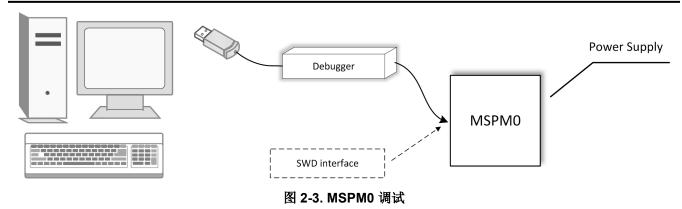
MSPM0 支持用于标准串行线调试的 XDS110 和 J-Link 调试器。

德州仪器 (TI) XDS110 专为 TI 嵌入式处理器而设计。XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有用于 TI 14 引脚以及 Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps)连接到主机 PC。它在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针都支持所有具有嵌入式跟踪缓冲器(ETB)的 Arm 和 DSP 处理器中的内核和系统跟踪。有关详细信息,请参阅 XDS110 调试探针。

J-Link 调试探针是优化调试和闪存编程体验的最常见的选择。这得益于其创纪录的闪存加载程序、高达 3MiB/s 的 RAM 下载速度以及在 MCU 闪存中设置无限数量断点的能力。J-Link 还支持各种 CPU 和架构,包括 Cortex M0+。有关详细信息,请访问 Segger J-Link 调试探针页面。

图 2-3 展示了连接到 MSPM0 目标的 XDS110 探针的主要功能区域和接口的简要示意图。





2.4 迁移过程

迁移的第一步是查看产品系列并选择最佳的 MSPM0 MCU。选择 MSPM0 MCU 后,选择开发套件。开发套件包括可供购买的 LaunchPad 套件和适用于目标插座板的设计文件。TI 还提供免费的 MSPM0 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio Theia IDE 桌面版和云版组件提供。可使用本应用手册的外设部分来帮助将软件从 NXP 器件移植到 MSPM0。最后,软件移植后,使用我们的调试工具下载并调试应用程序。

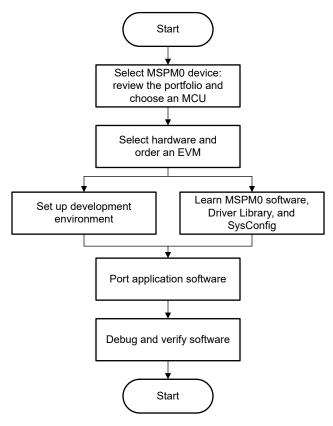


图 2-4. MSPM0 迁移流程图

2.5 迁移和移植示例

为了让您更加熟悉 TI 生态系统并更好地开始使用 MSPMO,本节说明了基本应用程序的逐步迁移过程。

为了演示从 NXP 移植到 MSPM0 的过程,本说明以现有 UART 示例为起点,来介绍将基本低功耗 UART 应用程序从 NXP 器件移植到 MSPM0 器件的步骤。此示例首先介绍了配有 UART 模块的 NXP KM35x 器件的 UART 示例。

1. 选择合适的 MSPM0 MCU。

www.ti.com.cn 生态系统和迁移

迁移的第一步是为应用程序选择正确的 MSPM0 器件。为此,可使用本指南的产品系列部分选择 MSPM0 系列。可以使用产品选择工具将范围缩小至特定的器件。在选择 NXP KM35x 零件的替代件时,只要选择正确的替换器件,MSPM0 器件就可以匹配几乎所有功能。务必确保所选的 MSPM0 具有可用于要迁移的代码的外设集。MSPM0 还提供许多引脚对引脚可扩展选项,从而能够轻松扩展到存储器更大或更小的器件,而无需更改系统中的任何其他内容。

在本示例中,我们选择了 MSPM0G3507 作为该应用的最佳器件。

2. 选择硬件并订购 EVM。

使用评估模块 (EVM) 可以加快迁移过程。对于 MSPM0 MCU, LaunchPad 套件是最容易上手的硬件。 LaunchPad 套件易于使用,因为它们附带内置编程器,旨在实现快速开发。

MSPM0L1105 具有可用于移植软件的 LaunchPad 开发套件 (LP-MSPM0G3507)。

3. 设置软件 IDE 和 SDK。

在移植软件之前,必须选择并设置软件开发环境。图 2-5 显示了 MSPM0 支持的所有 IDE。对于所选的任何 IDE,迁移和移植过程都是类似的。应使用最新版本的 MSPM0 SDK。

在本示例中, TI的 CCS-Theia 是所选的 IDE。

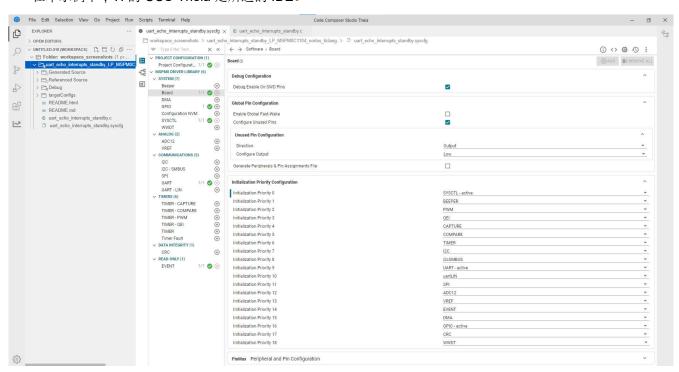


图 2-5. Code Composer Studio IDE

4. 软件移植。

准备好环境后,开始使用 MSPM0 SDK。MSPM0 SDK 为软件开发提供了不同的层。请查看 MSPM0 的 TI 驱动程序和 Driverlib 支持,了解与 NXP 器件驱动程序等效的驱动程序。大多数 MSPM0 用户发现 DriverLib 级别的软件最适合其应用程序,因此大多数 MSPM0 软件示例也基于 DriverLib。本示例使用 DriverLib。



移植工程时的一个选项是尝试使用等效的 MSPM0 DriverLib API 替换代码的每个部分,但这通常不是最简单的方法。通常,最好先了解被移植的应用程序代码。然后,从最接近的 MSPM0 示例工程开始,对其进行修改以匹配原始代码功能。下面将使用 2.16.00.00 SDK 版本的 MCUXpresso SDK_2.x_TWR-KM35Z75M 中的 UART 终端示例工程来展示此过程。对于使用许多外设的更复杂的工程,通常会针对每个外设重复该过程。

a. 了解应用程序。

以下说明来自 NXP 的 SDK 示例 "twrkm35z75m_lpuart_interrupt"。

The <code>lpuart_functioncal_interrupt</code> example shows how to use <code>lpuart</code> driver functional API to receive data with interrupt method:

In this example, one <code>lpuart</code> instance connect to PC, the board will send back all characters that PC send to the board.

第一步是了解 MCU 的主要设置。这通常是时钟速度和电源策略。在此示例中,器件不使用低功耗模式。 所指定的系统时钟频率为 72MHz,由器件的 "OSC" 或系统振荡器生成。UART 外设时钟源自 OSC。它进 行分频以允许 UART 以 15200 波特、8 个数据位、1 个起始位和停止位运行,无奇偶校验。没有使用硬件 流控制。

b. 找到最接近的 MSPM0 示例。

下一步是了解 KM35x 和 MSPM0 的 UART 模块之间的任何差异,然后在 MSPM0 SDK 中找到最接近的示例。这可以通过参考 第 4 节的 UART 部分轻松完成。该部分重点介绍 UART 模块之间的差异以及指向与 UART 相关的 MSPM0 SDK 代码示例的链接。对于本示例,SDK 中最接近的示例可能是 uart_echo_interrupts_standby,其中"当器件处于待机模式时 UART RX/TX 使用中断回显"。

该 MSPM0 示例与要移植的工程类似,但不完全相同。此示例仅回传在器件的 TX 引脚上接收到的数据。 对该 C 代码进行小幅调整即可与原始示例保持一致。

c. 导入并修改示例。

找到类似的示例后,打开 CCS 并导入代码示例,方法是转到 Project > Import CCS Projects... 并导航至 MSPM0 SDK 的示例文件夹。导入示例。以下是导入的 *uart_echo_interrupts_standby* 示例。这是一个 SysConfig 工程,因此主 C 文件很简单。它首先调用 SysConfig driverlib 初始化,这是 SysConfig 自动生成的用于配置器件的函数。然后,它启用 UART 中断。最后,它进入睡眠状态,等待任何 UART 事务。如果接收到 UART 事务,它会以"Hello World!"进行响应。

www.ti.com.cn 生态系统和迁移

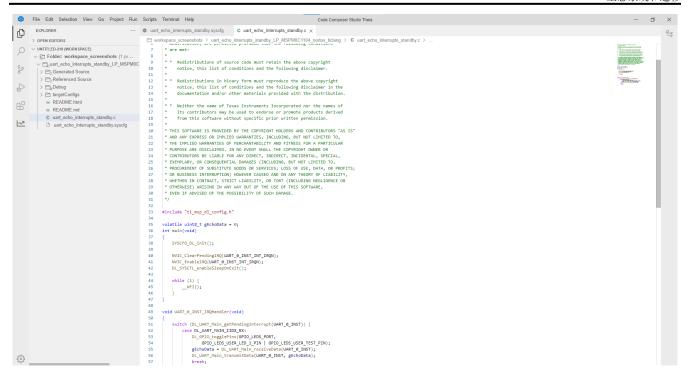


图 2-6. uart_echo_interrupts_standby

要查看 SysConfig 配置,请打开.syscfg 文件,该文件默认在"SYSCTL"选项卡上打开。有关使用 SysConfig 的详细指南,请参阅 MSPM0 SDK 中的 SysConfig 指南。

此示例已设置 UART 外设,因此无需更改在此文件中找到的任何配置。如果需要,可以更改时钟源、时钟分频器、目标波特率等设置。在此迁移演示中,配置将保持不变。

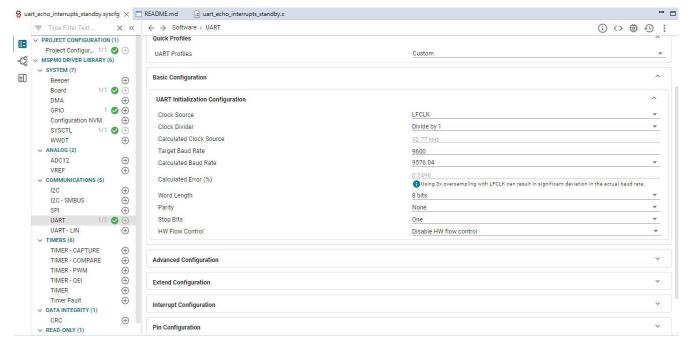


图 2-7. Sysconfig UART 选项卡



该示例还使用了一些 NXP 示例中不包含的 GPIO。这些 GPIO 仅用于调试目的,其中一个用于驱动 LED。可以在演示时保留这些内容,或者如果更合适的话,可以将其删除。

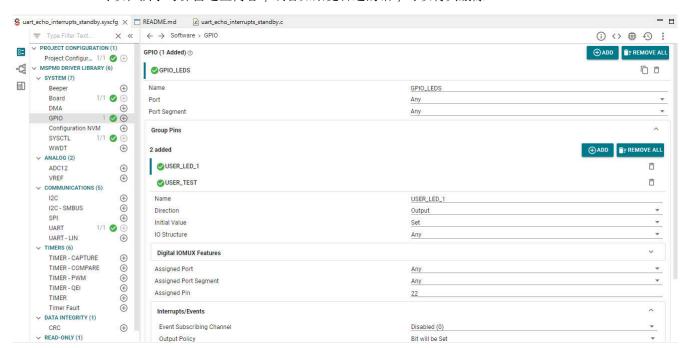


图 2-8. Sysconfig GPIO 选项卡

保存并重建工程后,SysConfig 会更新该示例的 ti_msp_dl_config.c 和 ti_msp_dl_config.h 文件。此时,已修改示例硬件配置,以匹配正在移植的原始软件的全部功能。唯一剩下的工作是应用程序级软件检查传入的 UART 字节,以切换 LED 并使用 "Hello World!" 进行响应。这可以通过编辑 uart_echo_interrupts_standby.c 文件中的少量代码来实现。

www.ti.com.cn 生态系统和迁移

```
README.md
uart_echo_interrupts_standby.syscfg
                                                    uart_echo_interrupts_standby.c ×
26 * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
27 * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
28 * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
29 * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32
33 #include "ti_msp_dl_config.h"
35 volatile uint8_t gEchoData = 0;
36 static uint8_t gMessage[12] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'W', 'o', 'r', 'l', 'd', '!'};
38 int main(void)
39 {
40
       SYSCFG_DL_init();
41
42
       NVIC ClearPendingIRQ(UART 0 INST INT IRQN);
43
       NVIC EnableIRQ(UART 0 INST INT IRQN);
44
       DL SYSCTL enableSleepOnExit();
45
46
       while (1) {
47
             _WFI();
48
49 }
50
51 void UART 0 INST IRQHandler(void)
       switch (DL UART Main getPendingInterrupt(UART 0 INST)) {
53
54
           case DL UART MAIN IIDX RX:
55
               DL GPIO togglePins(GPIO LEDS PORT,
                   GPIO LEDS USER LED 1 PIN | GPIO LEDS USER TEST PIN);
56
57
               gEchoData = DL UART Main receiveData(UART 0 INST);
58
               for(int i = 0; i < 12; i++){
59
                   DL_UART_Main_transmitDataBlocking(UART_0_INST, gMessage[i]);
60
               break;
61
62
           default:
63
               break;
64
       }
65 }
66
```

图 2-9. uart_echo_interrupts_standby.c

对应用程序代码进行了两处更改。首先,消息阵列必须进行初始化,以便器件可以正确响应 UART 消息。为此,在 gEchoData 初始化下方插入以下行:

```
static uint8_t gMessage[12] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!'};
```

第二步实际是使用 for 循环和 UART 发送函数的阻塞版本来处理数据发送,因此一次只发送一个字符,Tx 缓冲区中没有数据冲突。这通过将以下代码添加到 UART RX ISR 来实现:



5. 调试和验证。

以下各图演示了该代码示例的正确功能。如第一个图所示,在 PC 上使用终端程序将 UART 字符发送到 LP-MSPM0G3507 时,器件会以"Hello World!"进行响应。

在第二个图中,逻辑分析仪的捕获结果显示了器件的 RX 和 TX 线路,其中显示了传入的字符和传出的"Hello World!"。

每收到一个字符时,板载 LED 都将亮起再熄灭。

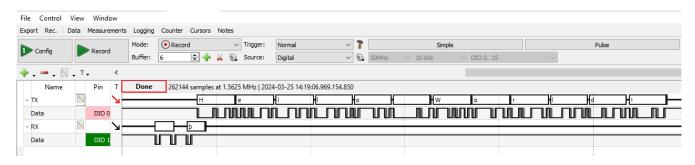


图 2-10. 逻辑分析仪捕获结果

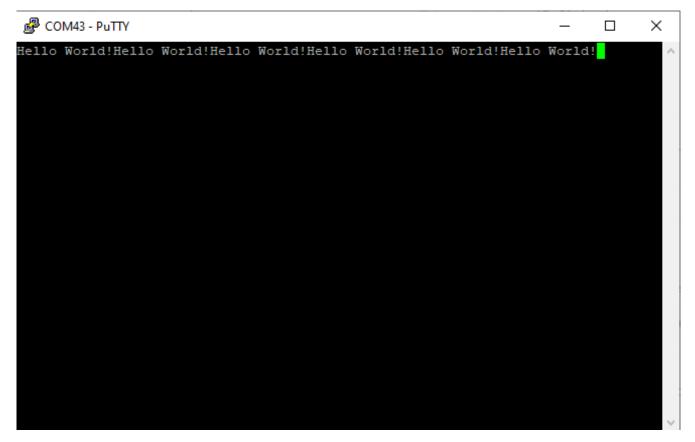


图 2-11. 串行终端

软件移植成功!如果这只是许多外设的第一个外设,请继续重复该过程并使用 SysConfig 组合每个块。

www.ti.com.cn 内核架构比较

3 内核架构比较

3.1 CPU

NXP 和 MSPM0 系列都使用了 Arm M0+32 位内核。表 3-1 高层次概述了 MSPM0G、MSPM0L 和 MSPM0C 器件与 NXP 器件中 CPU 之间的一般功能比较。节 3.6.1 比较了中断和异常以及它们在每款器件 M0 架构中包含的嵌套矢量中断控制器 (NVIC) 外设中的映射方式。

表 3-1. CPU 功能集比较

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G	MSPM0L	MSPM0C
架构	Arm Cortex-M0+	Arm Cortex-M0+	Arm Cortex-M0+	Arm Cortex-M0+	Arm Cortex-M0+	Arm Cortex-M0+
最大 MCLK	112MHz	20MHz	75MHz	32MHz 至 80MHz	32MHz	24MHz
CPU 指令缓存	高达 4 KB	否	64 位	4x64 位行 (32 字 节)	2x64 位行 (16 字 节)	否
处理器跟踪功能	是,集成微跟踪缓 冲器	否	是,集成微跟踪缓 冲器	是,集成微跟踪缓 冲器	否	否
存储器保护单元 (MPU)	是	否	是	是	否	否
系统计时器 (SYSTICK)	否	是	否	是(24位)	是 (24位)	否
硬件乘法	是	是	是	是	是	否
硬件断点/观察点	否	2/0	2/0	4/2	4/2	4/2
引导例程	ROM	ROM	ROM	ROM	ROM	ROM
引导加载程序存储 器	闪存(系统存储 器)	ROM	闪存(系统存储 器)	ROM	ROM	闪存(系统存储 器)
引导加载程序接口 支持 ^{(1) (2)}	适用于所有数据接 口	适用于所有数据接 口	适用于所有数据接 口	UART、I2C、 用户可扩展	UART、I2C、 用户可扩展	用户自定义
DMA	是 - 16 通道	否	是 - 4 通道	是 - 7 通道	是 - 3 通道	是 - 1 通道

⁽¹⁾ 有关可用性,请参阅器件特定数据表。

3.2 嵌入式存储器比较

3.2.1 闪存功能

MSPM0 和 NXP 系列 MCU 具有非易失性闪存,用于存储可执行程序代码和应用程序数据。

表 3-2. 闪存功能比较

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35	MSPM0G	MSPM0L	MSPM0C
闪存	高达 2MB 的程序/ 64kB FlexNVM 数 据	64KB	高达 512KB	128KB 至 32KB	64KB 至 8KB	16KB 至 8KB
存储器组织	1至3个块	单	块		单块	
块(组)大小	高达 512KB	64KB	高达 512KB		256KB	
扇区大小	2KB	512B	2KB		1KB	
闪存字大小	128/64 位	64 位		64 位加 8 个 ECC 位		CC、请参阅器件特 效据表
编程分辨率	32 位、16 位剪	₹8位(字节)	64 位闪存字	64 位闪存字(32 位、16 位或 8 位 , 请参阅器件特定的技术参考手册)		
擦除	页擦除 芯片擦除(所有 组)	不适用	扇区 2KB	扇区擦除 1KB/库擦除(最大 256KB)		256KB)
写保护	是的、静态				是,静态和动态	
读保护	否	是	否	是		
闪存读取操作	128 位闪存字	128 位闪存字	64 位闪存字	64 位	闪存字大小加8个E	CC 位

⁽²⁾ 其他接口将在以后的器件版本中提供。

表 3-2. 闪存功能比较 (续)

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35	MSPM0G	MSPM0L	MSPM0C
闪存写入操作	是	是	是	64 位闪存字大小 加 8 个 ECC 位		如果支持 ECC,请 持定数据表
FlexNVM(数据和 EEPROM 仿真)	读取/写入 32 位、 16 位或 8 位	不适用	不适用		不适用	
纠错码 (ECC)	是	是	否	对于 64 位为 8 位	如果支持 ECC,请	青参阅器件特定数据 表
预取	是	否	否	Į.		否

除了上表中列出的闪存功能外,MSPM0闪存还具有以下功能:

- 在整个电源电压范围内支持电路内编程和擦除操作
- 内部编程电压生成
- 支持 EEPROM 仿真,在低 32KB 闪存上支持多达 100 000 个编程/擦除周期,在剩余闪存上支持多达 10 000 个编程/擦除周期(32KB 的器件在整个闪存上支持 100 000 个周期)

3.2.2 闪存组织

闪存用于存储应用程序代码和数据、器件引导配置以及 TI 在出厂时预编程的参数。闪存分为一个或多个存储体,每个存储体中的存储器进一步映射到一个或多个逻辑存储区域,并分配有系统地址空间以供应用程序使用。

3.2.2.1 存储器组

大多数 MSPM0 器件会实现单个闪存组 (BANK0)。在具有单个闪存组的器件上,一个正在进行的编程/擦除操作会暂停对闪存的所有读取请求,直到操作完成并且闪存控制器已经释放了对组的控制。在具有多个闪存组的器件上,一个组上的编程/擦除操作也会暂停向正在执行编程/擦除操作的组发出的读取请求,但不会暂停向另一个组发出的读取请求。因此,存在多个组可实现以下应用案例:

- 双映像固件更新(应用程序可以从一个闪存存储体中执行代码,同时将第二个映像编程到第二个对称的闪存存储体,而不会暂停应用程序的执行)
- **EEPROM** 仿真 (应用程序可以从一个闪存存储体中执行代码,第二个闪存存储体用于写入数据,而不会暂停应用程序的执行)

3.2.2.2 闪存区域

根据每个组中存储器所支持的功能,每个组中的存储器映射到一个或多个逻辑区域。有四个区域:

- FACTORY 器件 ID 和其他参数
- NONMAIN 器件引导配置(BCR和BSL)
- MAIN 应用程序代码和数据
- DATA 数据或 EEPROM 仿真

具有一个存储体的器件在 BANK0(唯一存在的存储体)上实现 FACTORY、NONMAIN 和 MAIN 区域,并且数据区域不可用。具有多个存储体的器件也在 BANK0 上实现 FACTORY、NONMAIN 和 MAIN 区域,但包括可实现MAIN 或 DATA 区域的其他存储体(BANK1 至 BANK4)。

3.2.2.3 NONMAIN 存储器

NONMAIN 是闪存的专用区域,用于存储 BCR 和 BSL 用于引导器件的配置数据。该区域不用于任何其他目的。 BCR 和 BSL 都具有配置策略,这些策略可以保留为默认值(在开发和评估期间是典型值),也可以通过更改编程到 NONMAIN 闪存区域中的值来针对特定用途进行修改(在生产编程期间是典型值)。

3.3 上电和复位总结和比较

与 NXP M0 器件类似,MSPM0 器件配置了最低工作电压,并配有相应的模块,可通过将器件或器件的某些部分保持在复位状态来确保器件能正常启动。表 3-3 比较了这两个系列的实现方式以及哪些模块控制整个系列的上电过程和复位。

www.ti.com.cn 内核架构比较

表 3-3. 上电比较

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x		MSPM0 器件	
控制上电和 复位的模块	复位控制模块	复位控制模块	复位控制模块	控制加电和 复位的模块	PMCU(电源管理和时钟 单元)	
	基于电压电平的复位					
POR (上电 复位)	完整的器件复位。上电时发生第一级电压释放。断电时具有最低电压电平			POR (上电 复位)	完整的器件复位。上电时 发生第一级电压释放。断 电时具有最低电压电平。	
电平可配置 的 BOR (欠 压复位)	BOR (欠 用于触发复位的可编程阈值			可配置 BOR (欠压复 位)	可配置为复位或中断,具 有不同的电压阈值。	

NXP 器件定义了多个不同的复位类型,而 MSPM0 器件具有多个不同级别的复位状态。对于 MSPM0 器件,复位级别具有设定的顺序,当一个级别被触发时,所有后续级别都会被复位,直到器件被释放至运行模式。表 3-4 简 要说明了 MSPM0 复位状态。图 3-1 显示了所有 MSPM0 复位状态之间的关系。

表 3-4. 复位域比较

S32	K1xx、KEA128x 和 KM35 复位域	MSPM0 复位状态 ⁽¹⁾					
电源复位域	典型的触发条件为 POR、BOR ⁽³⁾	POR	现有内容				
无等效功能		引导复位 (BOOTRST) ⁽²⁾	现有内容				
系统复位域	典型的触发条件为外部引脚复位、低电压检测、WDT 复位 ⁽³⁾	系统复位 (SYSRST)	现有内容				
无等效功能		仅 CPU 复位 (CPURST)	现有内容				
RTC 域	(3)		现有内容				

- (1) 并未说明所有复位条件。有关所有可用的复位触发器,请参阅器件 TRM 的 PMCU 章节。
- (2) 如果 BOOTRST 是 NRST 或软件触发导致的,则 RTC、LFCLK 和 LFXT/LFLCK_IN 配置和 IOMUX 设置不会复位,从而允许 RTC 在 外部复位时保持运行。
- (3) 有关特定的复位条件、请参阅 NXP 器件特定 TRM 的复位和引导一章。



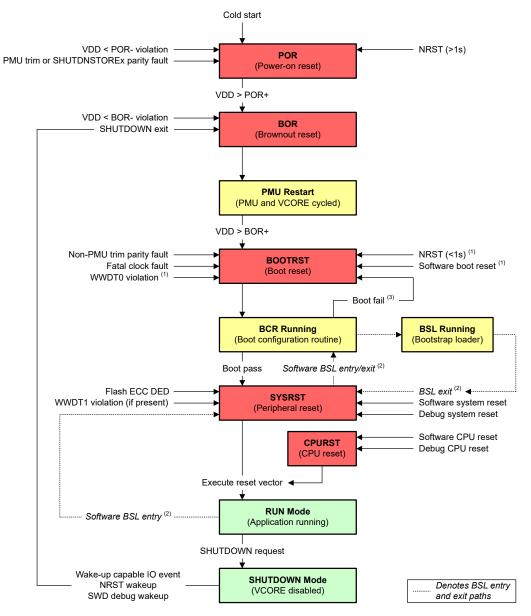


图 3-1. MSPM0 复位级别

www.ti.com.cn 内核架构比较

3.4 时钟总结和比较

NXP 的 MCU 和 MSPM0 均包含了能提供主时钟的内部振荡器。这些时钟可被分频,从而为其他时钟提供源并被分配到多个外设上。

表 3-5. 振荡器比较

振荡器	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G/L	MSPM0C
内部 RC	快速 IRC,慢速 IRC	不适用	内部 RC(4MHz)	SYSOSC ⁽¹⁾	SYSOSC (24MHz)
全摆幅晶体	SOSC	OSCCLK		HFXT	不适用
内部 RC	LP0 128kHZ	IRC 32kHz		LFOSC	32kHz
低频晶体	不适用	不适用	OSC32K	LFXT - 32kHz	不适用
低功耗晶体	不适用	1kHZ LPO	不适用	LFXT - 32kHz	不适用

(1) SYSOSC 可编程为 32MHz、24MHz、16MHz 或 4MHz。

表 3-6. 时钟比较

S32K1xx	KEA128x	KM35	MSPM0G	MSPM0L/C
SOSC	ICSOUTCLK	MCGOUTCLK	SYSOSC (4 -32MHz)	SYSOSC (24MHz)
SPLLDIV1	不适用	MCGPLLCLK	SYSPLLCLK1	不适用
SPLLDIV2	不适用	MCGFLLCLK	SYSPLLCLK0	不适用
不适用			SYSPLLCLK2x1	不适用
CORE_CLK	ICSOUTCLK	MCGOUTCLK	BUSCLK/ULPCLK2	BUSCLK/ULPCLK2
SIRC (8MHz)	IRC (37.5kHz)	IRC (32kHz)	LFOSC	(32kHz)
FIRC (48MHz)	不适用	IRC (4MHz)	SYSOSC	
LPO (128kHz)	LP0CLK	LPO (1kHz)	LFCLK (32kHz)	
不适用	OSCERCLK	IRTC/OSC32KCLK	RTCCLK	不适用
	SOSC SPLLDIV1 SPLLDIV2 CORE_CLK SIRC (8MHz) FIRC (48MHz) LPO (128kHz)	SOSC ICSOUTCLK SPLLDIV1 不适用 SPLLDIV2 不适用 不适用 CORE_CLK ICSOUTCLK SIRC (8MHz) IRC (37.5kHz) FIRC (48MHz) 不适用 LPO (128kHz) LPOCLK	SOSC ICSOUTCLK MCGOUTCLK SPLLDIV1 不适用 MCGPLLCLK SPLLDIV2 不适用 MCGFLLCLK 不适用 CORE_CLK ICSOUTCLK MCGOUTCLK SIRC (8MHz) IRC (37.5kHz) IRC (32kHz) FIRC (48MHz) 不适用 IRC (4MHz) LPO (128kHz) LPOCLK LPO (1kHz)	SOSC ICSOUTCLK MCGOUTCLK SYSOSC (4 -32MHz) SPLLDIV1 不适用 MCGPLLCLK SYSPLLCLK1 SPLLDIV2 不适用 MCGFLLCLK SYSPLLCLK0 不适用 SYSPLLCLK2x1 CORE_CLK ICSOUTCLK MCGOUTCLK BUSCLK/ULPCLK2 SIRC (8MHz) IRC (37.5kHz) IRC (32kHz) LFOSC FIRC (48MHz) 不适用 IRC (4MHz) SYS LPO (128kHz) LPOCLK LPO (1kHz) LFCLK

- 1. SYSPLLCLK2x 的速度是 PLL 模块输出速度的两倍,可进行分频。
- 2. BUSCLK 取决于电源域。对于电源域 0, BUSCLK 为 ULPCLK。对于电源域 1, BUSCLK 为 MCLK。

表 3-7. 外设时钟源

外设	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G	MSPM0L/C
RTC	LP01K_CLK , RTC_CLK	BUS_CLK、 LPOCLK、 ICSIRCLK、 OSCERCLK	EXTAL32	LFCLK (LFOSC \ LFXT)	不适用
UART	BUSCLK、 SOSCDIV2_CLK、 FIRCDIV2_CLK、 SPLLDIV2_CLK	BUSCLK	BUSCLK	BUSCLK、 ULPCLK、MFCLK、 LFCLK	BUSCLK、 ULPCLK、MFCLK、 LFCLK
SPI		BUSCLK	BUSCLK	BUSCLK、MFCLK、 LFCLK	BUSCLK、 ULPCLK、MFCLK、 LFCLK
I2C	BUSCLK、 SOSCDIV2_CLK、 FIRCDIV2_CLK、 SPLLDIV2_CLK	BUSCLK	BUSCLK	BUSCLK, MFCLK	BUSCLK、 ULPCLK、MFCLK、 LFCLK
ADC		BUSCLK、 OSCERCLK、 ADACK	OSCERCLK、 MCGPLLCLK	ULPCLK、HFCLK、 SYSOSC	SYSOSC , ULPCLK
LPTIM 1/2		TIMER_CLK	LPO、OSCERCLK、 MCGIRCLK、 ERCLK32K	LFCLK、ULPCLK、 LFCLK_IN	ULPCLK , LFCLK
计时器	SYS_CLK、 SOSCDIV1_CLK、 FIRCDIV1_CLK、 SPLLDIV1_CLK	TIMER_CLK , ICSFFCLK	BUSCLK	BUSCLK、MFCLK、 LFCLK	BUSCLK、 ULPCLK、MFCLK、 LFCLK

18



每个器件系列的器件特定 TRM 都有一个时钟树,可帮助使时钟系统可视化。Sysconfig 可以帮助您选择时钟分频以及为外设提供源。

www.ti.com.cn 内核架构比较

3.5 MSPM0 工作模式总结和比较

MSPM0 MCU 提供五种主要工作模式(电源模式),可根据应用要求优化器件功耗。这些模式按照功耗从高到低排列如下:RUN、SLEEP、STOP、STANDBY 和 SHUTDOWN。CPU 会在运行模式中执行代码。外设中断事件可将器件从睡眠、停止或待机模式唤醒至运行模式。关断模式会完全禁用内部内核稳压器,以更大限度地降低功耗,并且只能通过 NRST、SWD 或某些 IO 上的逻辑电平匹配来实现唤醒。运行、睡眠、停止和待机模式还包括多个可配置的策略选项(例如,RUN.x),用于平衡性能与功耗。

为了进一步平衡性能和功耗,MSPM0器件实现了两个电源域:PD1(用于CPU、存储器和高性能外设)和PD0(用于低速、低功耗外设)。在运行和睡眠模式下,PD1始终通电,但在所有其他模式下会禁用。PD0在运行、睡眠、停止和待机模式下始终通电。PD1和PD0在关断模式下都会禁用。

低功耗模式代码示例

导航至 SDK 安装目录,在 examples > nortos > LP name > driverlib 中找到低功耗模式代码示例

3.5.1 工作模式比较

NXP 器件具有类似的工作模式。表 3-8 简要比较了 NXP 器件和 MSPM0 器件。

表 3-8. NXP 器件和 MSPM0 器件的工作模式比较

S32K1XX 系列		KEA	128x	K	KM35x		MSPM0		
模式	说明	模式	说明	模式	说明	模式	说明		
						运行	0	提供完整的时钟 和外设	
运行/高速运行		运行	提供完整的时钟和外设	运行	提供完整的时钟和外设		1	SYSOSC 处于 设定的频率; CPUCLK 和 MCLK 限制为 32kHz	
						2	SYSOSC 被禁 用; CPUCLK 和 MCLK 限制 为 32kHz		
VLPR	时钟速度降 低;大多数外 设保持启用状 态	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用			
VLPS	CPU 停止;一	正常等待	CPU 停止;外	正常等待	CPU 停止;外	睡眠	0	不对 CPU 计时	
	些时钟和外设 保持启用状态		设单独启用		设单独启用		1	与运行 1 相同, 但不对 CPU 计 时	
						2	与运行 2 相同, 但不对 CPU 计 时		
STOP	CPU 和系统时 钟停止;一些	正常停止	CPU 和系统时 钟停止;一些外	正常停止	CPU 和系统时 钟停止;一些外	停止	0	睡眠 0 + PD1 被禁用	
	外设保持启用 状态	保持启用	设任	设保持启用状态		1	睡眠 1 + SYSOSC 档位 切换至 4MHz		
				2	睡眠 2 + ULPCLK 限制 为 32kHz				



表 3-8. NXP 器件和 MSPM0 器件的工作模式比较 (续)

S32K1XX 系列		KEA128x		KM35x		MSPM0		
模式	说明	模式	说明	模式	说明	模式	说明	
						待机	0	具有 BOR 功能 的最低功耗;所 有 PD0 外设都 可以接收 32kHz 的 ULPCLK 和 LFCLK; RTC 可用于 RTCCLK
							1	只有 TIMG0 和 TIMG1 可以接 收 32kHz 的 ULPCLK 或 LFCLK; RTC 可用于 RTCCLK
						关断	内核稳压	BOR 或 RTC。 关闭。PD1 和 用。退出触发复 DR。

3.5.2 低功耗模式下的 MSPM0 功能

如表 3-8 所示,在低功耗工作模式下,MSPM0 外设或外设模式的可用性或运行速度可能会受到限制。有关具体详细信息,请参阅特定于 MSPM0 器件的数据表中的"按操作模式支持的功能"表,例如:

MSPM0G350x 混合信号微控制器数据表

MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表

MSPM0C110x 混合信号微控制器数据表

MSPM0 器件的另一项功能是某些外设能够执行异步快速时钟请求。这使 MSPM0 器件能够处于低功耗模式,在该模式下外设未处于活动状态,但仍然能够触发或激活外设。当异步快速时钟请求发生时,MSPM0 器件能够快速将内部振荡器提升至更高的速度和/或暂时使其进入更高的工作模式以处理即将发生的操作。这允许通过计时器、比较器、通用的输入/输出(GPIO)和 RTC 快速唤醒 CPU;接收 SPI、UART 和 I2C;或触发 DMA 传输和 ADC 转换,同时在最低功耗模式下睡眠。有关异步时钟请求实现以及外设支持和用途的具体详细信息,请参阅器件特定 MSPM0 TRM 中相应的章节。

MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册

MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器技术参考手册

3.5.3 进入低功耗模式

与 NXP 器件类似, MSPM0 器件在执行等待事件 __wFE(); 或等待中断 __wFI(); 指令时会进入低功耗模式。低功耗模式由当前电源策略设置决定。器件电源策略由驱动程序库函数设置。以下函数调用将该电源策略设置为待机 0。

DL_SYSCTL_setPowerPolicySTANDBY0();

STANDBYO 可替换为选择的工作模式。有关管理电源策略的 driverlib API 的完整列表,请参阅 MSPM0 SDK DriverLib API 指南的这一部分。另请参阅以下代码示例,这些示例演示了如何进入不同的工作模式。每个 MSPM0 器件都有类似的示例。

3.6 中断和事件比较

www.ti.com.cn 内核架构比较

3.6.1 中断和异常

MSPM0 和 NXP MCU 都根据器件的可用外设来寄存和映射中断和异常矢量。表 3-9 中包含每个器件系列的中断矢量的总结和比较。中断或异常的优先级值越低,优先级就越高。对于其中的一些矢量,优先级是用户可选的,而对于其他矢量,优先级是固定的。

在 MSPM0 和 NXP MCU 中,NMI、复位和硬故障处理程序等异常被赋予负优先级值,以指示它们的优先级始终高于外设中断的优先级。在中断优先级可选的外设中,两个器件系列均最多提供 4 个可编程优先级。

表 3-9. 中断比较

IRQ 编号	NXP		MSPM0		
	中断/异常	优先级	中断/异常	优先级	
-	复位		Re	固定:-3	
-	NMI 处理程序		NMI 处理程序	固定:-2	
-	硬故障处理程序		硬故障处理程序	固定:-1	
-	SVCall 处理程序		SVCall 处理程序	 可选	
-	PendSV		PendSV	可选	
-	SysTick		SysTick	可选	
			INT_GROUP0-6 [WWDT0、 DEBUGSS、FLASHCTL、WUC FSUBx 和 SYSCTL]: M0G		
0	DMA0 : KM35x	可选	INT_GROUP0、2-6 [WWDT0、 DEBUGSS、FLASHCTL、WUC FSUBx 和 SYSCTL]: M0L	可选	
			INT_GROUP0-6 [WWDT0、 DEBUGSS、FLASHCTL 和 SYSCTL]: M0C		
	DMA1 : KM35x	可选	INT_GROUP0-5 [GPIO0、GPIO1、 COMP0、COMP1、COMP2、 TRNG]: M0G		
1			INT_GROUP0 , 2 [GPIO0 , COMP0]: M0L	可选	
			GPIO0 : M0C		
2	DMA2 : KM35x	可选	TIMG8:M0G, M0C	可选	
	DIVIZ : NIVIOOX	刊起	TIMG1 : M0L	刊匹	
3	DM3 : KM35x	可选	UART3:M0G	可选	
4	SPI0/SPI1/SPI2: KM35x	可选	ADC0 : M0G	可选	
·		1,2	ADC: M0L, M0C	.1%3	
5	FTMRE : KEA128x	可选	ADC1 : M0G	可选	
	PDB0:KM35x	1,2		.1%3	
6	PMC: KE128x/KM35x	可选	CANFD0 : M0G	可选	
7	TMR0 : KM35x	可选	DAC0 : M0G	可选	
	外部 IRQ:KE128x	1,2	21.33 1.11.3	.176	
8	TMR1 : KM35x	可选	保留	可选	
	I2C0 : KEA128x	17.00	ЖШ	可选	
9	TMR2 : KM35x	可选	SPI0: M0G、M0L、M0C	可选	
	I2C1 : KEA128x	-1 VE	OF TO . INIOCK INIOCK INIOC	-1 VE	
10	TMR3 : KM35x	可选	SPI1: M0G、M0L、M0C	可选	
	SPI0 : KEA128x	刊处	OF TELEVISION WIDEN WIDE	可选	
11	PIT0/PIT1: KM35x	可选	保留	可选	
	SPI1 : KEA128x	刊处		H1 Y/F	



表 3-9. 中断比较 (续)

ズ 3-9. 中断に牧 (突) IRQ 編号 NXP MSPM0					
	中断/异常		中断/异常 1		
	LLWU : KM35x	767692	1 3121 11	优先级	
12	UART0 : KEA128x	可选	保留	可选	
	FLASH : KM35x				
13	UART1 : KEA128x	可选	UART1: M0G、M0L	可选	
	ACMP0/ACMP1/ACMP2 : KM35x				
14	UART2 : KEA128x	可选	UART2	可选	
	SLCD : KM35x				
15	ADC0 : KEA128x	可选	UARTO: MOG、MOL、MOC	可选	
	ADC : KM35x		TIMG0 : M0G \ M0L		
16	ACMP0 : KEA128x	可选	TIMG14 : M0C	可选	
	PTx : KM35x		11111014 1 111100		
17	FTM0 : KEA128x	可选	TIMG6 : M0G	可选	
	RNGA : KM35x		TIMA0 : M0G		
18	THYOA : THYIOOX	可选	TIMG2 : MOL	可选	
10	FTM1 : KEA128x	刊起	TIMA0 : MOC	内处	
	UARTx : KM35x		TIWAU : WICC		
19	FTM2 : KEA128x	可选	TIMA1 : M0G	可选	
	MMAU : KM35x		TIMG7 : M0G		
20	RTC : KEA128x	可选	TIMG4 : MOL	可选	
	AFE_CH0 : KM35x		TIMG4 . MOL		
21	AFE_CHU : KNI35X ACMP1 : KEA128x	可选	TIMG12 : M0G	可选	
	AFE_CH1 : KM35x				
22	PIT_CH0 : KEA128x	可选	保留	可选	
23	AFE_CH2 : KM35x	可选	保留	可选	
	PIT_CH1 : KEA128x				
24	AFE_CH3: KM35x	可选	I2C0 : M0G、M0L、M0C	可选	
	KBIO : KEA128x				
25	IRTC : KM35x	可选	I2C1: M0G、M0L、M0C	可选	
	KBI1 : KEA128x				
26	I2C0/I2C1 : KM35x	可选	保留	可选	
	保留:KEA128x				
27	LPUART0 : KM35x	可选	保留	可选	
	ICS : KEA128x				
28	MCG: KM35x	可选	AES: M0G	可选	
	WDOG: KEA128x				
29	WDOG/EWM : KM35x	可选	保留	可选	
	PWT : KEA128x	_		المارية. ما لات	
30	LPTMR0/LPTRM1 : KM35x	可选	RTC : M0G	可选	
	MSCAN_RX: : KEA128x	_		.476	
31	XBAR : KM35x	可选	DMA: M0G、M0L、M0C	可选	
	MSCAN_TX : KEA128x			-1765	

www.ti.com.cn 内核架构比较

3.6.2 事件处理程序和扩展中断和事件控制器 (EXTI)

MSPM0 器件包含一个专用事件管理器外设,它扩展了 NVIC 的概念,允许将来自外设的数字事件作为中断传输到 CPU,作为触发器传输到 DMA,或传输到另一个外设以触发硬件操作。事件管理器还可以与电源管理和时钟单元 (PMCU) 进行握手,以确保存在必要的时钟和电源域,从而执行触发事件操作。

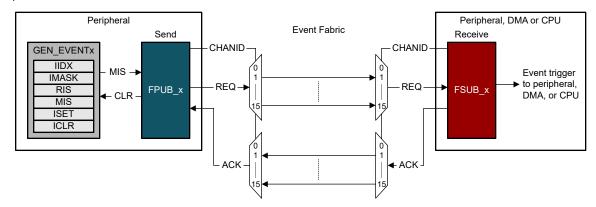


图 3-2. 通用事件路由

在 MSPM0 事件管理器中,生成事件的外设称为发布者,而基于发布者执行操作的外设、DMA 或 CPU 称为订阅者。可用发布者和订阅者的潜在组合非常灵活,可以在移植软件时使用,以替代以前由中断矢量和 CPU 处理的功能,从而完全绕过 CPU。例如,I2C 转 UART 桥接器可能先前在接收到 I2C 停止时触发了 UART 传输,使用 ISR 设置标志,或直接加载 UART TX 缓冲区。利用 MSPM0 事件处理程序,I2C 事务完成事件可以触发 DMA 直接加载 UART TX 缓冲区,因此无需 CPU 进行任何操作。

要获取有关在 MSPM0 中使用事件处理程序的更多详细信息,请参阅 *MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考 手册* 或 *MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册* 的*事件* 部分。

3.7 调试和编程比较

Arm SWD 2 线 JTAG 端口是 MSPM0 和 NXP 的主要调试和编程接口。该接口通常在应用程序开发期间和生产编程期间使用。表 3-10 比较了两个器件系列的功能。有关 MSPM0 调试接口安全功能的其他信息,请参阅 *MSPM0 MCU 中的网络安全机制*。

表 3-10. 编程/调试接口特性比较

	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0		
调试端口		Arm SWD 端口(两线制)		Arm SWD 端口(两线制)		
断点单元 (BPU)	两夕	一硬件断点;无限的用户软件	断点	四个硬件断点		
数据观察单元 (DWT)	四个观察点	两个图	见察点	两个观察点		
微跟踪缓冲器 (MTB)	是	否	是	4 个跟踪数据包支持 MTB#none#		
低功耗调试支持	否	不适用	否	是		
EnergyTrace 支持	不适用	不适用	不适用	EnergyTrace+ 支持(CPU 状态与功耗性能评测)		
调试期间的外设运行支持	是	不适用	是	是		
调试接口锁定	是	不适用	是	可以永久禁用调试功能, 或者可以使用密码锁定		

3.7.1 引导加载程序(BSL) 编程选项

引导加载程序 (BSL) 编程接口是 Arm SWD 的替代编程接口。该接口仅提供编程功能,通常通过标准嵌入式通信接口使用。这允许通过与系统中用于连接其他嵌入式器件的现有接头或外部端口进行固件更新。尽管编程更新是该接口的主要用途,但它也可用于初始生产编程。表 3-11 比较了 MSPM0 和 NXP 器件系列的不同选项和功能。

表 3-11. BSL 功能比较

NOTH DOL SHEAR						
BSL 特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0		
BSL 在空白器件上启动	否	不适	用	是		
自动检测编程接口	否	不适	用	是		
安全性	是	不适	用	安全启动选项; CRC 保护		
可定制	否	不适用		不适用 是,可		是,可配置调用引脚和插 件功能
调用方法	跳转/调用指令	不适用		在发生 BOOTRST、SW 进入时 1 个引脚处于高电 平		
支持的接口						
UART	是	不适	用	是		
I2C	是	不适用		是		
SPI	是 <mark>(1)</mark>	不适用		需要自定义插件		
CAN	是(1)	不适	用	己计划插件(1)		

(1) 模式选项可用性取决于器件。

www.ti.com.cn 数字外设比较

4 数字外设比较

4.1 通用 I/O (GPIO、IOMUX)

MSPM0 GPIO 功能涵盖了 S32K1xx 和 KEA128x 器件提供的所有功能,并额外提供了一些功能。NXP 使用术语 GPIO 来指代可设置、复位或切换的引脚。不过,MSPM0 使用稍微不同的命名法,即:

- MSPM0 GPIO 指能够读取和写入 IO、生成中断等的硬件。
- MSPM0 IOMUX 指负责将不同内部数字外设连接到引脚的硬件。IOMUX 为许多不同的数字外设提供服务,包括但不限于 GPIO。

MSPM0 GPIO 和 IOMUX 模块涵盖的功能与 NXP 的 GPIO、PORT 和 TRGMUX/SMU 模块相同。MSPM0 器件还提供了一些其他功能,而 NXP S32K1xx、KEA128x 和 KM35x 器件不提供这些功能。

	农 4-1. GFIO 为能比权						
特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G、MSPM0L、 MSPM0C			
输出模式	推挽 具有上拉或下拉的开漏	推挽 具有下拉的开漏	推挽 具有上拉或下拉的开漏	推挽 具有上拉或下拉的开漏			
GPIO 速度选择	同步路径 1.5*Tmax = 31.25ns @48MHz 异步路径:50ns	10.2ns 上升时间,9.5ns 下降时间	8.0ns 上升时间,5.0ns 下降时间	ODIO 引脚:120ns 所有其他:0.3* fmax = 3.75ns(80MHz 时)			
高驱动 GPIO	每个高驱动端口引脚的 12mA	20mA	是	等效,称为高驱动 IO (HDIO)			
输入模式	悬空 上拉/下拉 模拟	悬空 上拉 模拟	悬空 上拉/下拉 模拟	等效			
原子位设置和复位	是	是	是	等效			
替代功能	配置了信号多路复用单元	配置了 PORT 模块	配置了 PORT 模块	等效 MSPM0 使用 IOMUX			
唤醒	GPIO 引脚中断	不适用	等效	等效			
DMA 控制的 GPIO	是	否	是	是			
用户控制的输入滤波,可抑制小于 1、3 或 8 个 ULPCLK 周期的干扰	等效	等效	等效	是			
用户可控制的输入迟滞	是	是	否	是			

表 4-1. GPIO 功能比较

GPIO 代码示例

有关 GPIO 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

4.2 通用异步接收器/发送器 (UART)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 提供用于异步(无时钟)通信的外设。S32K1xx 和 KM35x 系列提供支持基本 UART 的低功耗 UART,而 KEA128x 和 KM35x 提供常规 UART 模块。在 MSPM0 中,这些 UART 外设有两种型号,一种具有标准功能,另一种具有高级功能。在 NXP 的器件中,UART 提供单一版本。表 4-2 比较了 MSPM0 的 UART 和 NXP 的 S32K1xx、KEA128x 和 KM35x UART。

农 4-2. OAN 							
特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0			
硬件流控制	是	否	是	是			
使用 DMA 的连续通信	是	否	是	是			
多处理器	否	否	否	是			
同步模式	否	否	否	否			
单线半双工通信	是	是	是	是(1)			
从低功耗模式唤醒	是	是	是	是			
数据长度	7、8、9、10	8.9	8.9	5、6、7、8			

表 4-2. UART 功能集比较

表 4-2. UART 功能集比较 (续)

	• • •	/4/10//4/- D4 (->/)		
特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0
Tx/Rx FIFO 深度	4	不适用	8	4
IrDA 支持	是	否	是	仅限扩展的 UART
LIN 支持	是	是	是	仅限扩展的 UART
DALI 支持	否	否	否	仅限扩展的 UART
曼彻斯特编码支持	否	否	否	仅限扩展的 UART

(1) 需要在发送和接收之间重新配置外设

UART 代码示例

有关 UART 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

4.3 串行外设接口 (SPI)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都支持串行外设接口 (SPI)。总的来说,MSPM0 和 S32K1xx/KEA128x/KM35x SPI 的支持是相当的,但存在表 4-3 中列出的差异。

表 4-3. SPI 功能比较

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0
控制器或外设操作	是	是	是	是
数据位宽 (控制器模式)	8 位	8 位	8至16位	4 至 16 位
数据位宽 (外设模式)	8 位	8 位	8至16位	7至16位
				MSPM0C : 12MHz
最大速度	10MHz	12MHz	37.5MHz	MSPM0L: 16MHz
				MSPM0G: 32MHz
全双工传输	是	是	是	是
半双工传输(双向数据线)	是	否	是	否
单工传输(单向数据线)	是	是	是	是
硬件芯片选择管理	等效	等效	等效	是
可编程时钟极性和相位	是	是	是	是
具有 MSB 优先或 LSB 优先 移位的可编程数据顺序	是	是	是	是
SPI 格式支持	不适用	不适用	不适用	Motorola、TI、 MICROWIRE
硬件 CRC	否	否	否	否,MSPM0 提供 SPI 奇偶校验模式
TX FIFO 深度	4	不适用	8	4
RX FIFO 深度	4	不适用	8	4

SPI 代码示例

有关 SPI 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

4.4 I2C

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都支持 I2C。在 MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 中, I2C 功能均由 I2C 模块处理。

www.ti.com.cn 数字外设比较

表 4-4. I2C 功能比较

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0
控制器和目标模式	是	是	是	是
多控制器功能	是	是	是	是
标准模式(最高 100kHz)	是	是	是	是
快速模式(最高 400kHz)	是	是	是	是
超快速模式(最高 1MHz)	是	是	是	是
寻址模式	7 位或 10 位			
外设地址	1个地址(随后)	1 个地址	1 个地址	2 个地址
常规调用	是	是	是	是
可编程设置时间和保持时间	是	是	是	否
事件管理	否	否	否	是
时钟延展	是	是	是	是
软件复位	是	是	是	是
EIEO/極洲盟	月.(初阳校组聚)	不迁田	不迁田	TX:8字节
FIFO/缓冲器	是(仅限控制器)	不适用 	不适用 	RX:8字节
DMA	是(仅限目标)	否	否	是
可编程模拟和数字噪声滤 波器	否	等效	等效	是

I2C 代码示例

有关 I2C 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

4.5 计时器 (TIMGx、TIMAx)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都提供各种计时器。MSPM0 提供具有不同功能的计时器,支持从低功耗监控到高级电机控制的各种用例。

表 4-5. 计时器功能比较

		1-0. NI H1 1111 -0/1 11 C P			
特性	S32K1xx 计时器	KEA128x 计时器	KM35x 计时器	MSPM0G 计时器	MSPM0L 和 MSPM0C 计时器
分辨率	16 位	16 位	16 位	16 位、32 位	16 位
PWM	是	是	是	是	是
捕获	是	是	是	是	是
比较	是	是	是	是	是
单次触发	是	是	是	是	是
向上/向下计数功能	是	是	是	是	是
电源模式	是	是	是	是	是
QEI 支持	否	否	否	是	否
可编程预分频器	是	是	是	是	是
影子寄存器模式	否	否	否	是	是
事件/中断	是	是	是	是	是
故障事件机制	等效	等效	等效	是	否
自动重新加载功能	是	是	是	是	是

计时器代码示例

有关计时器代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

4.6 窗口化看门狗计时器 (WWDT)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都提供窗口看门狗计时器。当应用程序未能在指定的时间窗口内签入时,窗口看门狗计时器 (WWDT) 会启动系统复位。

表 4-6. WWDT 命名

ACT OF THE PARTY O						
密钥	S32K1xx/ KEA128x/KM35x	MSPM0				
名称	看门狗计时器	窗口化看门狗计时器				
缩写名称(相同的顺序)	WDOG	WWDT				

表 4-7. WDT 功能比较

W. T. T. T. STIBLE IX						
特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0		
窗口模式	是	是	是	是		
间隔计时器模式	否	否	否	是		
LFCLK 源	是	是	是	是		
中断	是	是	是	是		
计数器分辨率	16 位	16 位	32 位	25 位		
时钟分频器	是	是	是	是		

WWDT 代码示例

有关 WWDT 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

4.7 实时时钟 (RTC)

MSPM0 ¹ 且一些 NXP 的 M0 MCU 提供实时时钟 (RTC)。S32K1xx/KEA128x/KM35x 器件包含一个专用的 RTC 模块。实时时钟 (RTC) 模块为应用程序提供时间跟踪,并以可选的二进制或二进制编码十进制数格式提供秒、分钟、小时、星期几、一月中的第几日和年的计数器。

表 4-8. RTC 功能比较

ACTORICO WHENCE						
特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G		
电源模式	是	是	是	是		
二进制编码格式	否	否	否	是		
闰年校正	否	否	是	是		
可定制警报的数量	1	1	1	2		
内部或/和外部晶体	不适用	不适用	是	是		
晶体偏移校准	否	否	否	是		
预分频器块	等效	是	否	是		
中断	是	是	是	是		

RTC 代码示例

有关 RTC 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

5 模拟外设比较

5.1 模数转换器 (ADC)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 均能提供 ADC 外设,将模拟信号转换为数字等效信号。表 5-1 比较了 ADC 的不同功能和模式。

表 5-1. 功能集比较

特性	NXP S32K1xx	NXP KEA128x	NXP KM35x	MSPM0
分辨率(位)	12	12	16	2012/10/08

¹ 仅 MSPM0G 器件支持 RTC.

表 5-1. 功能集比较 (续)

特性	NXP S32K1xx	NXP KEA128x	NXP KM35x	MSPM0
bb bb b b b b b b b b b b b b b b b b				MSPM0Gx - 4
转换速率 (MSPS) (12 位)	1.16	0.340	4.75	MSPM0Lx - 1.68
<u> </u>				MSPM0Cx - 1.5
过采样(位)	否	否	否	14
硬件过采样	否	否	否	128x
FIFO	否	是	否	是
	替代: 2.7 ≤ V _{REF} ≤ V _{DDA} +0.1	内部: V _{SSA} 至 V _{DDA}	替代: V _{SSA} 至 V _{DDA}	内部:1.4、2.5 VDD
ADC 基准 (V)	主要: 2.7 ≤ V _{REF} ≤ V _{DDA} +0.1	外部: 外部:	l '	外部: 1.4 ≤ V _{REF} ≤ V _{DD}
工作电源模式	VLPR、STOP2、RUN	运行、等待、停止	运行、等待、VLPS	运行、睡眠、停止、待机(1)
自动断电	等效	等效	等效	是
外部输入通道 ⁽²⁾	S32K118-最高 16	高达 16	高达 16	MSPM0Gx - 高达 17
/ / P · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S32K116-最高 13	同心 10	向心 10	MSPM0Lx/Cx - 高达 10
内部输入通道	电源监测器	内部间隙,温度传感器	内部间隙,温度传感器	温度传感器、电源监控、 模拟信号链
DMA 支持	是	否	是	是
ADC 窗口比较器单元	否	否	否	是
	T	- 	<u>*</u>	MSPM0Gx - 是
同时采样 	否	否	否	MSPM0Lx/Cx - 否
ADC 粉具 (3)	1	1	1	MSPM0Gx - 2
ADC 数量 ⁽³⁾	1	'	'	MSPM0Lx/Cx - 1

- (1) ADC 可以在待机模式下触发,从而改变工作模式。
- (2) 外部输入通道的数量因器件而异。
- (3) ADC 的数量因器件而异。

表 5-2. 转换模式

模式	S32K1xx	NXP KEA128x	NXP KM35x	MSPM0	说明
单次转换模式	是	是	是	单通道单次转换	ADC 对单个通道进行 一次采样和转换
扫描一个通道序列	否	否	否	序列通道单次转换	ADC 对序列通道进行 采样并转换一次。
	是	是	是	单通道重复转换	重复单通道连续采 样,转换一个通道
连续转换模式	否	否	否	序列通道重复转换	对序列通道进行采样 和转换,然后重复相 同的序列
不连续模式	否	否	否	序列通道重复转换	对一组不连续的通道 进行采样和转换。通 过将 MEMCTRLx 映 射到不同的通道,可 在 MSPMO 上完成该 操作。

ADC 代码示例

有关 ADC 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

5.2 比较器 (COMP)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 均能在某些器件上提供集成比较器作为可选外设。在 MSPM0 系列器件中,比较器表示为 COMPx,其中最后一个字符"x"指所考虑的特定比较器模块。S32K1xx 系列配有 COMP 模块和附有六至八个输入端的内部单路比较器,KEA128x 系列最多支持四个输入端,KM35x 最多支持六个输入端。MSPM0 比较器模块使用其具有两个可编程电平的 DAC 提供窗口比较器功能。MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都配有可从各种内部和外部源获取输入的多个通道,并可用于触发电源模式变化或截断/控制 PWM 信号。表 5-3 汇总了 MSPM0和 NXP M0 比较器模块逐功能比较结果。

表 5-3. COMP 功能集比较

特性	S32K1xx	KEA128x	P 切配集CL牧 KM35x	MSPM0G	MSPM0L
可用的比较器	1	2	3	高达 3	1
正负输入数量	多达 6 个正输入、6 个负输入 多达 8 个正输入、8 个负输入	多达 4 个正输入、4 个负输入	多达6个正输入、6 个负输入	多达 4 个正输入、3 个负输入	多达 2 个正输入、2 个负输入
	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚
输出路由	中断	中断	中断	中断/事件接口	中断/事件接口
		6-6-6-17-16-71-18-	6-6-6-11-1-1	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚
	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	DAC12 输出 ⁽¹⁾	DAC8 输出
同相输入源				DAC8 输出	
LAJIH TRIJY V VAN	DAC8 输出 DAC6 输出	DAC6 输出	DAC6 输出	内部 V _{REF} : 1.4V 和 2.5V	OPA1 输出 ⁽²⁾
				OPA1 输出 ⁽²⁾	
	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚	多路复用 I/O 引脚
	否	否	否	内部温度传感器	内部温度传感器
反相输入源	DAC8 输出	DAC6 输出	DAC6 输出	内部 V _{REF} :1.4V 和 2.5V	DAC8 输出
	否	否	否	DAC8 输出	OPA0 ⁽³⁾ 输出
	否	否	否	OPA0 输出 ⁽³⁾	Of AOC 7 and Ed
	无、15mV/19mV、	4mV、32mV/	5m\/ 10m\/	无、10mV、20mV、 30mV	无、10mV、20mV、 30mV
可编程迟滞	23mV/34mV、32mV/ 46mV		20mV、30mV	从 0V 到 V _{REF} /V _{DD} 的 其他值 (使用 DAC8)	从 0V 到 V _{DD} 的其他 值 (使用 DAC8)
寄存器锁	否	否	否	是,某些 COMP 寄存 器 (写入时需要密 钥)	是,某些 COMP 寄存 器 (写入时需要密 钥)
窗口比较器配置	是	否	是	是	否 (单个 COMP)
输入短路模式	否	否	否	是	是
工作模式	VLPR (仅限 LS 比 较)、停止 1、停止 2、运行	运行、等待、停止	运行、等待、VLPS	高速、低功耗	高速、低功耗
快速 PWM 关断	否	否	否	是(通过 TIMA 故障 处理程序)	否
输出滤波	低通滤波器	否	是	消隐滤波器	消隐滤波器
1111 山 1/16 (人)	以四佖伙的	Ė	厂	可调节模拟滤波器	可调节模拟滤波器
输出极性控制	是	是	是	是	是
	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿	上升沿
中断	下降沿	下降沿	下降沿	下降沿	下降沿
	双边沿	双边沿	双边沿	输出就绪	输出就绪

www.ti.com.cn 模拟外设比较

表 5-3. COMP 功能集比较 (续)

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G	MSPM0L
交换输入模式	是	是	是	是	是

- (1) 仅适用于具有 DAC12 外设的器件
- (2) 仅适用于具有 OPA1 外设的器件
- (3) 仅适用于具有 OPA0 外设的器件

COMP 代码示例

有关 COMP 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

5.3 数模转换器 (DAC)

S32K1xx、KEA128x 和 KM35x MCU 系列在其 COMP 模块中配置了基本 DAC。但是,在从 M0 系列迁移到 MSPM0 系列时,您可以使用 MSPM0 内部 12 位 DAC 来生成模拟电压。MSPM0 系列器件提供 12 位 DAC 外设,能为各种应用执行数模转换。在 *MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册*、MSPM0 系列器件数据表和 MSPM0 SDK 中,12 位 DAC 外设称为 DAC12。这将 DAC12 与 8 位 DAC 区分开来,后者可用于给定 MSPM0 器件中包含的每个比较器外设。本文档的比较器部分介绍了这些额外的 8 位 DAC。该 DAC12 外设仅在 MSPM0G 系列器件上可用。

表 5-4 总结了 MSPM0G 的 12 位 DAC 外设的功能。

表 5-4. DAC 功能集比较

	٦	以 3-4. DAU 切配来LUV	~	
特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G
分辨率	8 位	6 位	6 位	12 位 (11 ENOB)
输出速率	不适用	不适用	不适用	1MSPS
输出通道	1	1	1	1 ⁽¹⁾
数据格式	不适用	不适用	不适用	8 位右对齐,12 位右对 齐,二进制补码或直接二 进制
DMA 集成	否	否	否	是
			DAC 输出	外部引脚
输出路由	路由 仅内部外设连接:CMP 仅内部外设连接:CMP	内部外设连接:CMP	内部外设连接:OPA IN+、 COMP IN+、ADC0	
内部基准电压	是、1V 或 VDDA	是、1.2V 或 VDDA	是、1.2V 或 VDDA	是 , 2.5V 或 1.4V
外部基准电压	否	否	否	是
FIFO	否	否	否	是
输出缓冲器	否	否	否	是
可配置输出失调电压	否	否	否	是
自校准模式	否	否	否	是
自动波形生成	否	否	否	否
采样保持模式	否	否	否	否
触发源	工作时钟,触发启动信号	不适用	触发启动信号	内部专用采样时间发生器、DMA中断/事件、 FIFO 阈值中断/事件、两个 硬件触发器(可从事件结 构获得)

⁽¹⁾ 双 DAC 通道计划用于未来的 MSPM0G 器件。

DAC12 代码示例

有关 DAC12 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。



5.4 运算放大器 (OPA)

NXP S32K1XX、KEA128x 和 MK35x MCU 系列器件不提供集成运算放大器 (OPA) 外设,但在从 S32K1XX、KEA128x 和 KM35x 系列器件迁移到 MSPM0 系列器件时,您可以使用 MSPM0 内部 OPA 替换外部分立式器件或根据需要缓冲内部信号。MSPM0 OPA 模块非常灵活,可以单独或组合替换检测或控制应用中的许多分立式放大器。表 5-5 包含了 MSPM0 OPA 模块的主要功能,下述 OPA 代码示例包含您可以重新创建的常见 OPA 配置示例。

表 5-5. MSPM0 OPA 功能集

特性	MSPM0 实施
输入类型	轨至轨(可以启用或禁用)
松 米 # 中	1MHz (低功耗模式)
增益带宽	6MHz (标准模式)
	通用模式
	缓冲器模式
放大器配置	PGA 模式 (反相或同相)
	差分放大器模式
	级联放大器模式
输入/输出路由	外部引脚布线
110/ V/110 LL F1 LL	ADC 和 COMP 模块的内部连接
故障检测	烧毁电流源 (BCS)
	标准(可选斩波频率)
斩波稳定	ADC 辅助斩波
	禁用
	内部 VREF (仅限 MSPM0G 器件)
基准电压	DAC12 (仅限 MSPM0G 器件)
	DAC8(仅限具有 COMP 模块的器件)

OPA 代码示例

有关 OPA 代码示例的信息,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

5.5 电压基准 (VREF)

MSPM0 和 NXP 的 M0 MCU 都具有内部基准,可用于为内部外设提供基准电压并输出到外部外设。

表 5-6. 功能集比较

特性	S32K1xx	KEA128x	KM35x	MSPM0G	MSPM0L MSPM0C
内部基准 (V)	2.7 , 5.5	2.7 , 5.5	2.7 , 3.6	1.4 , 2.5	1.4 , 2.5
外部基准 (V)	高达 VDD	高达 VDD	高达 VDD	外部:1.4 ≤ V _{REF} ≤ V _{DD}	外部:1.4 ≤ V _{REF} ≤ V _{DD}
输出内部基准	否	否	否	是	是
在内部连接到 ADC	是	是	是	是	是
在内部连接到 DAC	是	是	是	是	否
在内部连接到 COMP	是	是	是	是	否
在内部连接到 OPA	不适用	不适用	不适用	是	否

对于 MSPM0 VREF, 您必须启用电源位 PWREN 位 0 (ENABLE)。

VREF 代码示例

有关使用 VREF 的代码示例,请参阅 MSPM0 SDK 示例指南。

6参考资料

- MSPM0 SDK 用户指南
- 适用于 MSPM0 的 SysConfig 指南
- LP-MSPM0G3507
- LP-MSPM0L1306
- MSPM0C1104
- TMDSEMU110-U
- 德州仪器 (TI): 附有 CAN-FD 接口数据表的 MSPM0G350x 混合信号微控制器
- 德州仪器 (TI): MSPM0L130x 混合信号微控制器数据表
- 德州仪器 (TI): MSPM0C110x、MSPS003 混合信号微控制器数据表
- 德州仪器 (TI): MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册
- 德州仪器 (TI): MSPM0 L 系列 32MHz 微控制器技术参考手册
- 德州仪器 (TI): MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器技术参考手册
- MSPM0 驱动程序库概述
- 德州仪器 (TI): *MSPM0 MCU 中的网络安全机制*

重要通知和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。 严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 的销售条款或 ti.com 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址:Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265 版权所有 © 2025,德州仪器 (TI) 公司